

## 300-Millimeter-Halbleiterwerk Dresden

13. Juli 2022

PI 11315

### Allgemeine Informationen

- Investitionssumme rund eine Milliarde Euro
- Grundstück ca. 100 000 m<sup>2</sup>  
(ca. 14 Fußballfelder)
- Gesamtnutzfläche ca. 72 000 m<sup>2</sup> Fertigungs- und Büroflächen  
  
ab 2022: Neubau eines Entwicklungs- und Laborgebäudes (in Konzeptionierung) im Rahmen von IPCEI II
- Reinraumfläche aktuell ca. 10 000 m<sup>2</sup>,  
Erweiterung um ca. 3 000 m<sup>2</sup> ab 2022  
(verfügbar ab 2024/25)
- Bauverlauf Spatenstich Frühjahr 2018  
Maschineninstallation Ende 2019  
Erster vollautomatisierter Produktionsdurchlauf Januar 2021  
Eröffnung Juni 2021  
Serienproduktion Juli 2021
- Mitarbeiter im Endausbau bis zu 700;  
ca. 380 Mitarbeiter im Juli 2022

- **Gesuchte Berufsqualifikationen** Experten aus der Halbleiterindustrie, wie Prozess-, Produktions- oder Instandhaltungsingenieure, Mathematiker, Softwareentwickler sowie Berufserfahrene und Absolventen aus Studienrichtungen wie Physik, Chemie und Mikrosystemtechnik
- **Fertigungstechnologie** Hochautomatisierte Halbleiterproduktion (300-mm-Siliziumsubstrate (Wafer) mit Strukturbreiten bis 65 nm)
- **Gefertigte Produkte** Anwendungsspezifische integrierte Schaltungen (ASICs), Leistungshalbleiter  
  
MEMS Fertigung auf 300 mm Wafern (SOP in 2026)
- **Einsatzgebiete der Halbleiter** Überwiegend in der Automobilelektronik, als auch in Elektrowerkzeugen von Bosch Power Tools
- **Vernetzte Produktion** In der Halbleiterfabrik in Dresden entstehen Produktionsdaten im Umfang von 250 Mbyte / Sekunde, das entspricht dem Datenvolumen von 400 parallel laufenden Videos in HD.

## Informationen zum Bauwerk

- **Gesamtbaumasse** 600 000 m<sup>3</sup>
- **Betonbedarf** ca. 66 500 m<sup>3</sup>  
(etwa 8 300 Lkw-Betonmischer)
- **Stahlbedarf** ca. 16 400 Tonnen  
(etwa 30 A380-Passagierflugzeuge)

- Erdbewegungen/-aushub ca. 90 000 m<sup>3</sup>  
(etwa 7 500 Lkw-Ladungen)
- Bohrpfähle für das Fundament ca. 860 Stück
- Bodenplatte 100 cm Dicke
- Länge der Rohrleitungen ca. 80 km
- Länge der Elektroleitungen ca. 380 km  
(2 x Strecke Berlin-Dresden)
- Förderung  
Der Bau der neuen Halbleiterfabrik in Dresden wurde durch die Bundesrepublik Deutschland im Rahmen IPCEI I (Important Project of Common European Interest) gefördert. Zuwendungsgeber war das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz.

Bosch investiert weiter am Standort in Dresden. Eine Erweiterung der Reinraumfläche um 3 000 m<sup>2</sup> und der Bau eines Entwicklungs- und Laborgebäudes am Standort Dresden befinden sich aktuell in der Konzeptionierungsphase. Diese Vorhaben werden voraussichtlich durch das BMWK im Rahmen von IPCEI II gefördert. Die Genehmigung zum vorzeitigen Maßnahmenbeginn liegt vor.